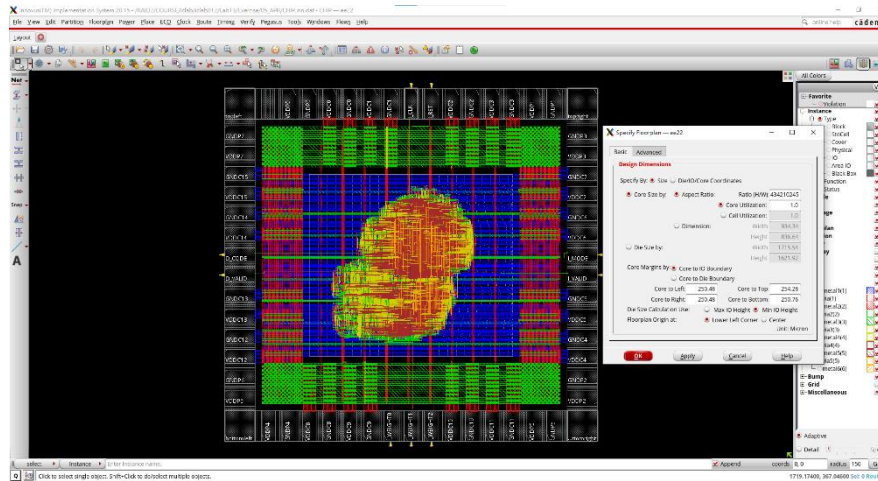
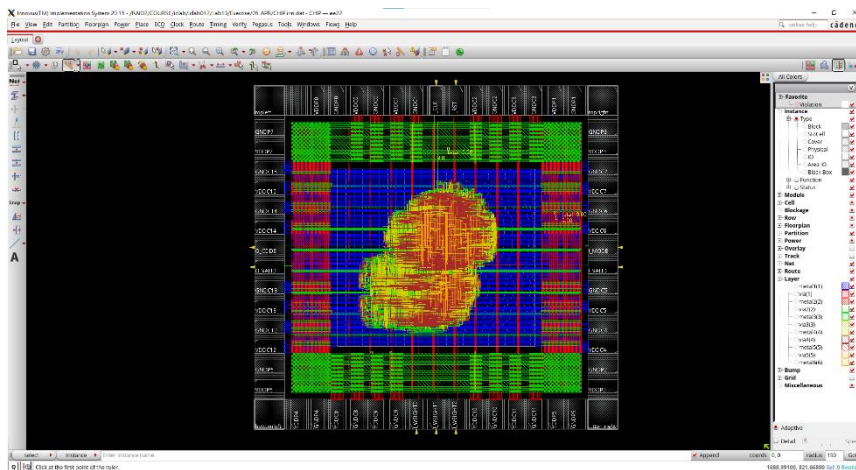


Report

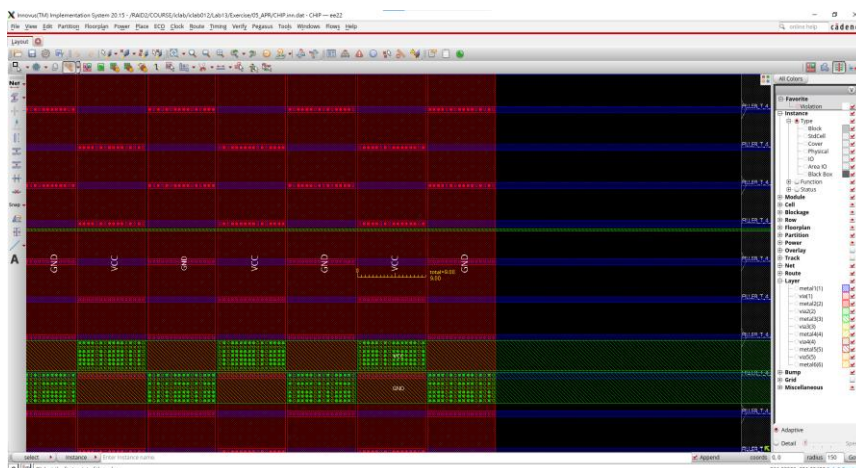
1. Core to IO boundary :



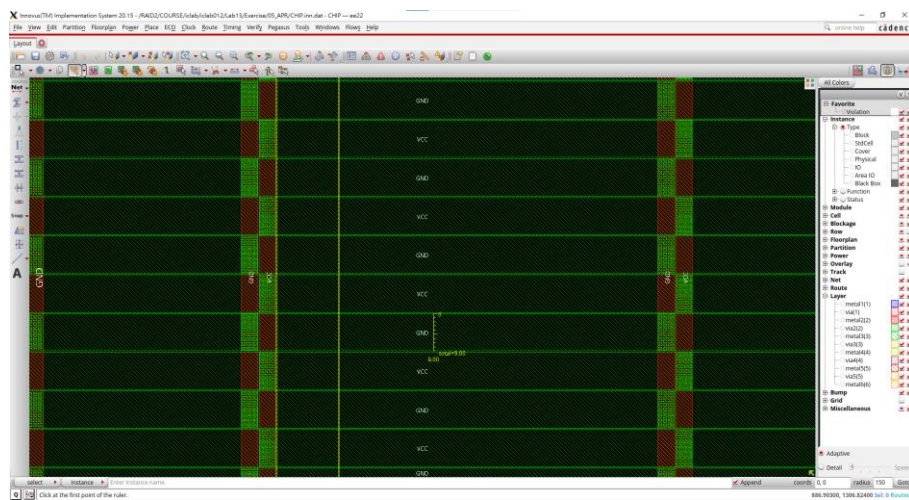
2. Core Ring :



OverAll Power Ring



Left Power Ring



Top Power Ring

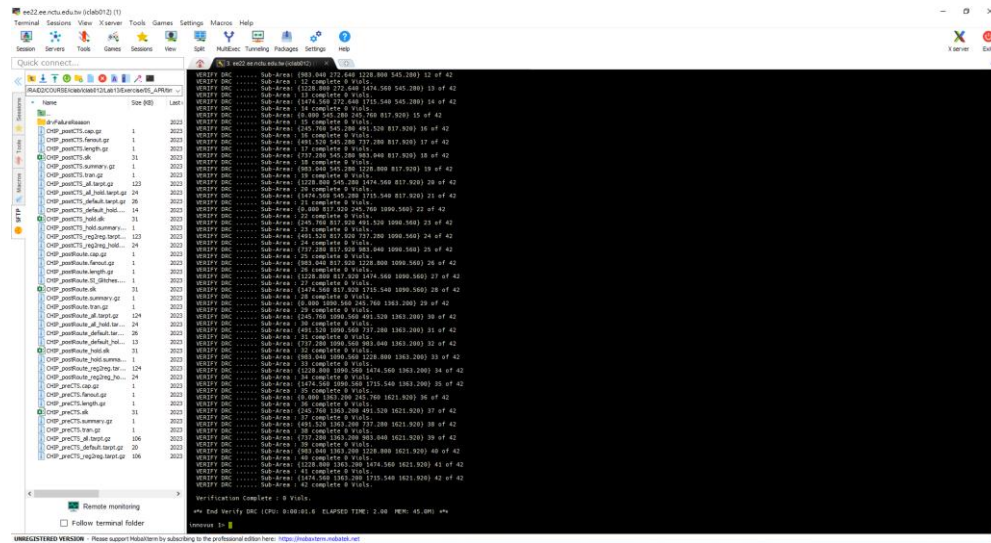


Right Power Ring

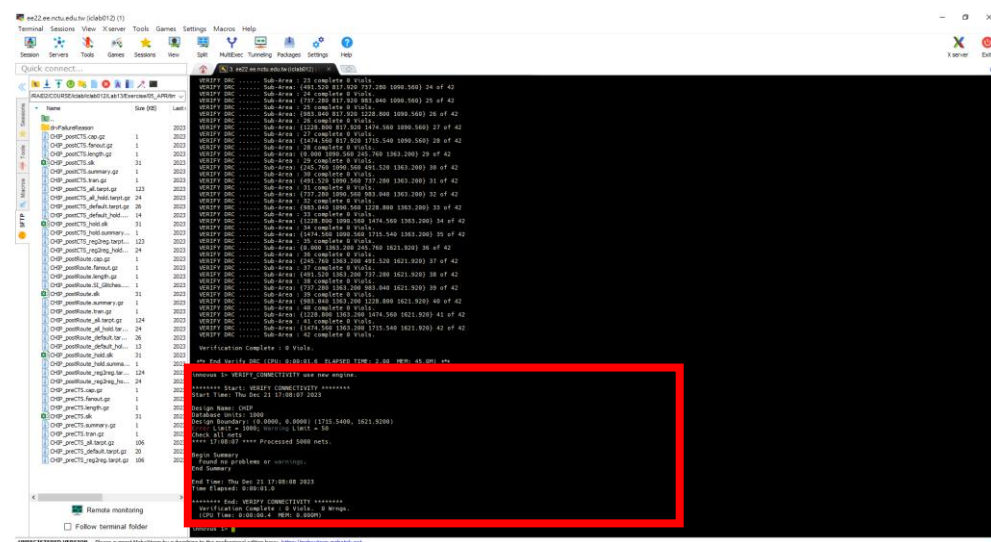


Down Power Ring

5. DRC result :

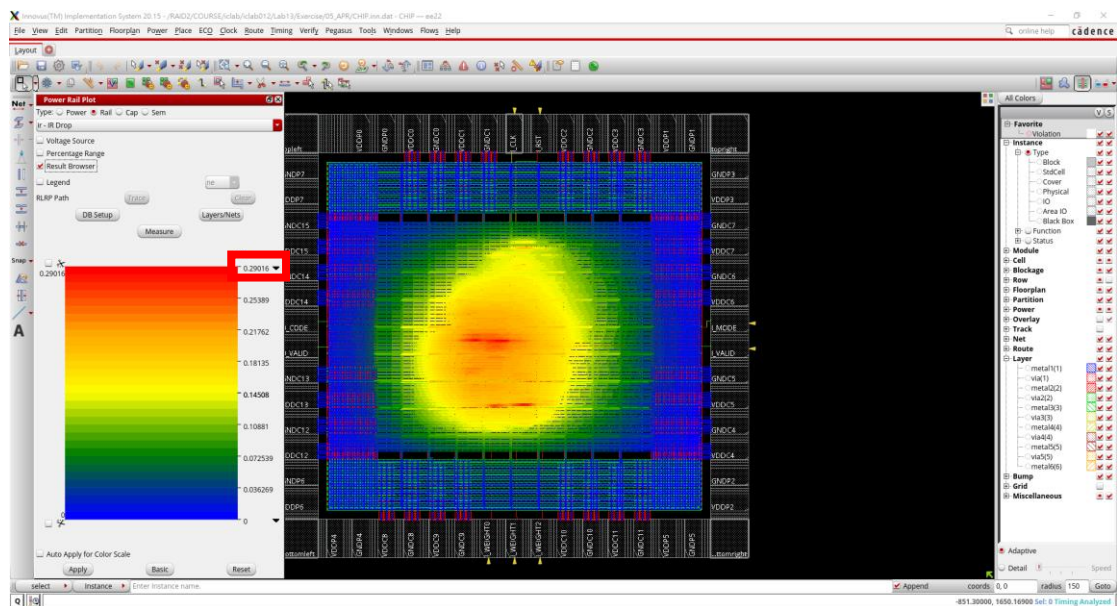


6. LVS result :



[illegible]

9. IR Drop Results :



避免IR Drop太大的問題 => 我在寫CHIP_shell.v時，有多開了幾組IO Power Pad，因為聽大助上課時有提到，會發生IR Drop的主因，就是因為電壓傳到CHIP裡面所需要的原件的路上經過太多wire以及buffer，導致電壓的下降。因此，我開了8組CHIP IO PAD以及16組的Core Power Pad。同時也把stripe width設成4，讓在有限的Core Area下，可以放置更多的Power Strip，減少Power跑到需要元件的路徑，進而減少IR Drop。